

LS16 Series

Non-illuminated/Vertical Type **LS16 Series**

LS16A



4.2(L)×4.2(W)×0.35(H)mm

LS16B



4.2(L)×4.2(W)×0.35(H)mm

LS16D



4.2(L)×4.2(W)×0.55(H)mm

■ 特徴 Features

1. 小型であるため実用上のレイアウトの融通性が高く、他のコンポーネントとの共用により大きな自由度を与え、セット設計が容易に行えます。
2. リフロー炉によるはんだ付けが可能な完全防水タイプです。

1. The compact size allows high layout flexibility and freedom of application in combination with other components, making set design easy.
2. This is a completely waterproof type that permits reflow oven soldering.

■ 用途 Applications

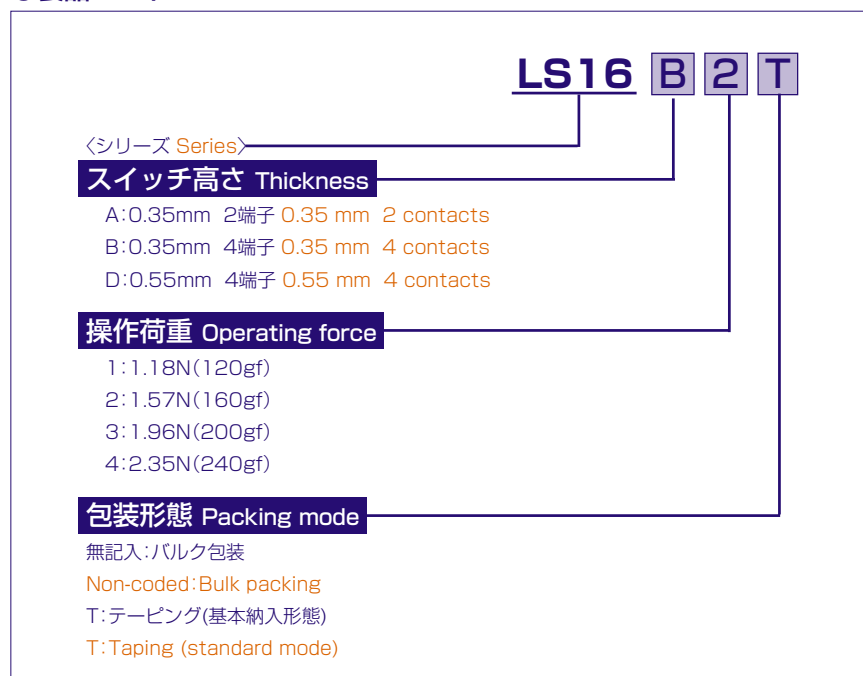
ルミスイッチLS16シリーズは操作スイッチとして次のような製品に使用できます。

携帯電話、TV、VTR、カメラ等。

LUMISWITCH, LS16 series, can be used as a function control switch in the following applications.

Portable telephones, TV, VCR, cameras, etc.

● 製品コード Product code



●電気的・機械的特性 Electro-Mechanical Characteristics

(Ta 25℃)

Item	スイッチ作動力 Switch operating force			
	1.18N	1.57N	1.96N	2.35N
最大定格 Maximum rating	DC12V 20mA			
接触抵抗 Contact resistance	100mΩ以下 100mΩ or less			
絶縁抵抗 Insulation resistance	100MΩ以上 100MΩ or more			
耐電圧 Withstanding voltage	AC250V 1分間 AC250V for one minute			
バウンス Bounce	20ms以下 20ms or less			
ストローク Stroke	0.2mm			
作動力 Operating force	1.18±0.39N	1.57±0.49N	1.96±0.49N	2.35±0.59N
動作寿命 Operating life (times)	10万回以上 100,000 or more	5万回以上 50,000 or more	5万回以上 50,000 or more	3万回以上 30,000 or more

●外形寸法図 Outline drawing

LS16A 回路図 Circuit diagram 極性マーク (白) Polarity mark (White) シルク印刷 Silk printing ※ダミーパターン Dummy pattern 推奨基板はんだ付けパターン The following soldering patterns are recommended for reflow-soldering: 単位 Unit : mm	LS16B 回路図 Circuit diagram 極性マーク (緑) Polarity mark (Green) シルク印刷 Silk printing 推奨基板はんだ付けパターン The following soldering patterns are recommended for reflow-soldering: 単位 Unit : mm
LS16D 回路図 Circuit diagram 極性マーク (黒) Polarity mark (Black) シルク印刷 Silk printing 推奨基板はんだ付けパターン The following soldering patterns are recommended for reflow-soldering: 単位 Unit : mm	注1) はんだ印刷用メタルマスクの厚さは0.1~0.15を推奨します。 A thickness of 0.1~0.15 is recommended for the metal mask for solder printing. 注2) 基板レジストパターンの寸法は、はんだ付けパターン外形+0.15(全周)で設計して下さい。 The dimensions of the board resist pattern should be designed according to the outline of the solder pattern plus 0.15 (all around). 注3) スイッチ中心公差は、スイッチ外形より±0.2mm以下となります。 The switch center tolerance is to be ±0.2mm or less from the outline of the housing. ※基板パターン処理はAuメッキです。 Board pattern finish is with gold (Au) plating.